

TIA®800FG 可大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上，这些胶带具有优秀的粘合强度和良好的导热率，旨在替代传统的机械固定和导热硅脂，简化组装工艺，提升产品可靠性，是解决现代紧凑型电子设备散热挑战的理想选择。



特性

- 》高粘结强度
- 》良好的导热效率
- 》施工便捷，可模切定制尺寸
- 》可在较宽工作温度范围内保持性能稳定

应用

- 》LED 模组
- 》功率器件
- 》消费电子
- 》通讯设备

TIA® 800FG 系列特性表

产品名称	TIA® 805FG	TIA® 806FG	TIA® 808FG	TIA® 810FG	TIA® 812FG	TIA® 815FG	TIA® 820FG	测试方法
颜色	白色							目视
胶粘剂类型	亚克力胶粘剂							-
基材类型	玻璃纤维							-
厚度 (inch/mm)	0.005 0.13	0.006 0.15	0.008 0.20	0.010 0.25	0.012 0.30	0.015 0.38	0.020 0.51	ASTM D374
击穿电压 (V)	≥2500	≥3000	≥3500	≥4000	≥4200	≥4500	≥5000	ASTM D149
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 125							-
导热系数 (W/m·K)	0.8							ASTM D5470
180°剥离强度 (gf/inch) 不锈钢, 即时	≥1000							ASTM D3330
180°剥离强度 (gf/inch) 不锈钢, 24小时	≥1200							ASTM D3330
保持力 (H/inch) @25°C	≥48							ASTM D3654
保持力 (H/inch) @80°C	≥48							ASTM D3654

产品规格

标准厚度: 0.005" (0.13 mm) , 0.006" (0.15 mm) , 0.008" (0.20 mm) , 0.010" (0.25 mm) , 0.012" (0.30 mm) , 0.015" (0.38 mm) , 0.020" (0.51 mm)

标准尺寸: 16" × 100" (406 mm × 30.48 m)

补强载体: TIA®800FG系列卷材可带玻璃纤维为补强

TIA®系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd(兆科科技有限公司)及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担。Ziitek(兆科)本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek(兆科)及其标志为公司或关联公司所有。



TIA800FG-0126